訂正表

いつもご愛顧いただき、ありがとうございます。

このたび、ご購入いただきました書籍『パワーデバイスの最新開発動向と高温対策および利用技術』の内容に不備がございました。心よりお詫び申し上げます。

記

訂正箇所

第5章「パワーデバイスの高温対策に向けた実装・パッケージング」内、第1節「パワーモジュールの放熱冷却構造」におきまして、文章中に誤りがございました。

訂正内容は以下の通りです。

P.154 「1.2.1 ベースレス、ベースアタッチレス構造」の最終行

誤

「パッケージ裏面に露出した絶縁回路基板に前述のPC-TIMが印刷されることもある」

正

「パッケージ裏面に露出した絶縁回路基板に**TIM**が印刷されることもある」

→プレアプライタイプを印刷するが、耐熱性が低いフェーズチェンジ (PC) ではないため。

以上

弊社では以後このようなことがないように、チェック体制を徹底してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社R&D支援センター 事務局

info@rdsc.co.jp

TEL 03-5857-4811